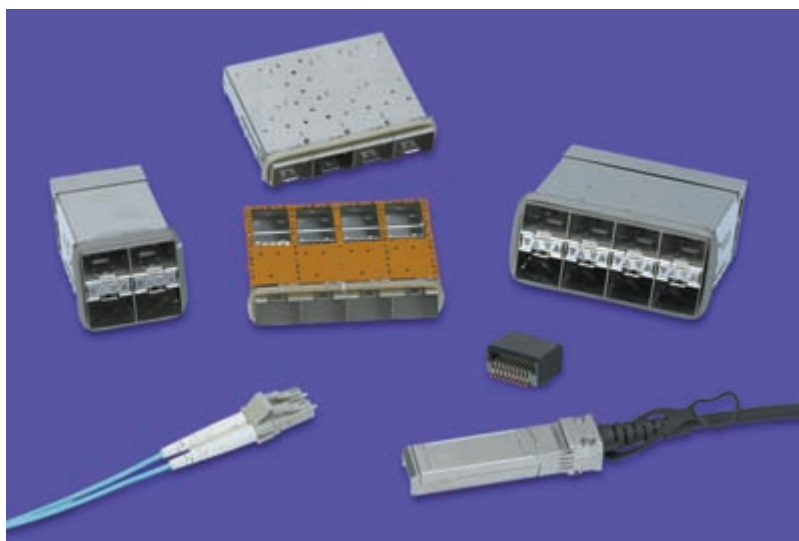


20-контактный SMT-разъем zSFP+ от Molex



Компания Molex Incorporated представляет усовершенствованный 20-контактный SMT (для поверхностного монтажа) разъем zSFP+ (Small Form-factor Pluggable Plus) для высокоскоростных решений в сфере телекоммуникаций и передачи данных.

Разработанные для каналов последовательной связи со скоростью передачи информации 25 Гб/с с высокоскоростными стандартами передачи данных Ethernet и Fibre Channel решения zSFP+ подходят для приложений нового поколения и обеспечивают оптимальные электромагнитные излучения и целостность сигнала для 10- и 16-гигабитных каналов.



Рис.1

Обратно совместимые zSFP+ коннекторы имеют такой же интерфейс и габаритные размеры, как форм-фактор SFP+. Коннекторы zSFP+ характеризуются «предпочтительным» способом сочленения для оптимизации сигнальных, механических и электрических характеристик и значительно снижение резонансных колебаний (по сравнению с серией SFP+).

В серию zSFP+ входят:

- 20-контактные соединители zSFP+ для поверхностного монтажа;
- стыкуемые интегрированные коннекторы;
- пассивные оптические кабельные сборки.

«SFP-коннекторы и стыкуемые интегрированные коннекторы претерпели много изменений в дизайне для достижения оптимальной производительности следующего поколения, – говорит Джо Дамбах, менеджер по новым продуктам компании Molex. – Новая технология поверхностного монтажа zSFP+ предлагает полностью интегрированные

решения для усовершенствования и разработки накопителей, коммутационных устройств, маршрутизаторов, коммутационных узлов на центральных станциях и многоплатформенных системах обработки данных».

20-контактный zSFP+ коннектор для поверхностного монтажа имеет такое же посадочное место на PCB, интерфейс сочленения и размеры EMI-корпуса для полной обратной совместимости, как и существующий дизайн SFP+. Корпус из высокотемпературного термопластика выдерживает температуры SMT-процесса пайки бессвинцовыми припоями. Однопортовые и 1x корпуса подходят для многопортовых применений, могут быть использованы с платами различной толщины и различными способами сборки, для серверов и коммутационных панелей по цене, совместимой с ценой SFP+.

EMI-корпуса доступны с двумя, 4-мя, 6-ю портами для различных вариантов дизайна.

Однопортовые и стыкуемые интегрированные коннекторы могут иметь контакты press-fit, что устраняет необходимость их пайки и предлагает компактный дизайн и легкость обработки. Внутренний вертикальный экран (кожух) обеспечивает значительное снижение электромагнитных помех. Контакты press-fit помогают максимально использовать место на печатной плате. Опционально доступны крышки со световодами для визуальной индикации статуса и активности порта. Опволоконные дуплексные кабельные сборки LC компании Molex с волокном OM3/OM4 используются с оптическими модулями zSFP+, предлагая высокопроизводительные решения с заказными параметрами длины геометрии (прямой, под углом 45° и 90°).

Дуплексные джамперы LC с волокном OM3/OM4 предлагают расширенный диапазон рабочих частот, необходимый для приборов zSFP+ нового поколения. Дуплексные LC коннекторы компании Molex отвечают стандартам EIA-TIA и FOCIS 10 и совместимы с приборами MSA.0.

«Улучшенные решения zSFP+ обеспечивают превосходное качество сочленения для приложений со скоростью 25 Гб/с, и клиенты компании Molex уже ощущают на себе все преимущества, применив данные коннекторы в решениях с меньшей скоростью, обеспечивающие резерв для ее увеличения в будущем», – добавляет Д. Дамбах.

За дополнительной информацией обращайтесь в офис официального дистрибьютора Molex на Украине – компанию СЭА по тел. (044) 291-00-41, e-mail: info@sea.com.ua, es@sea.com.ua



Рис.2